

湖南三安产品清单

碳化硅肖特基二极管, BV≥650V													
	IF(A)	2	4	6	8	10	12	16	20	40	60	80	100
封装类型	裸芯粒	●	●	●	●	●	●	●	●				
	DFN 8*8			●	●	●							
	TO252-2L	●											
	TO263-2L					●							
	TO220-2L	●	●	●	●	●	●	●	●				
	TO220N-2L				●	●							
	TO247-2L					●		●	●				
	TO247-3L					●		○	●	●			
	SOT227										●	●	●
碳化硅肖特基二极管, BV≥1200V													
	IF(A)	2	5	10	15	20	27	30	40	60	80	100	
封装类型	裸芯粒	●	●	●	●	●	●	●	●				
	TO252-2L	●	●										
	TO263-2L			●									
	TO220-2L	●	●	●	●	●							
	TO247-2L			●	●	●	●	●	●				
	TO247-3L			●		●		●	●				
	SOT227									●	●	●	
碳化硅MOSFET													
		BV≥1200V					BV≥750V		BV≥1700V				
Rdson(mR)		16	32		80		16	1000					
封装类型	裸芯粒	○	○		●		○	○					
	TO247-3L	○	○		●			○					
	TO247-4L		○		○								
	TO263-7L				○			○					
●	量产												
○	即将量产												

碳化硅二极管产品特性:

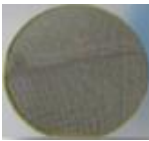
- 零反向恢复电流
- 电阻正温度系数特性
- 器件性能受温度影响小
- 超高开关速度
- 超低开关损耗
- 更小的散热器需求

碳化硅MOSFET产品特性:

- 低电容值, 可支持高开关速度
- 更高击穿电压和更低的导通电阻
- 更高的系统效率
- 更小的散热器需求
- 增加应用系统开关频率

裸芯粒

无封装芯片, 该类产品用于终端半导体厂商做模块封装或其他特定封装。



贴片型封装



贴片封装产品, 主要用于各种小功率电源PFC电流或其他整流电路, 功率范围主要在0~3000W, 电视电源、家电电源、手机适配器、电脑适配器、新能源汽车DC-DC转换器、小功率OBC、微型逆变器等。



DFN



TO-252



TO-263

插件型封装



插件产品是市场通用器件, 可用于各种PFC和桥式整流电路, 应用市场主要包括: 汽车OBC、DC-DC、充电桩、空调变频器、光伏逆变器、UPS、大功率LED电源、通信电源、各种工业设备电源等, 功率从几百瓦到几百千瓦不等。



TO-220



TO-247-2



TO-247-3



TO-247-4

模块



肖特基二极管模块, 主要用于一些特大功率的工业仪器电源, 或超级充电桩。



SOT-277